SILIKON GAP-FILLER PAD TGF-BXS-SI

ultra weich, elastisch

HALA

TGF-BXS-SI ist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfähiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem sich gute thermische Anbindungen über große Spaltmaße, z.B. durch Höhenunterschiede elektronischer Bauelemente oder große Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Füllung des Silikonelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine gute thermische Leitfähigkeit. Durch seine ultra Weichheit und Formanpassungsfähigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei minimalem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtübergangswiderstand minimiert. Durch seine natürliche Haftfähigkeit lässt sich das Material sehr gut vorapplizieren. Die auf einer Seite optional aufgebrachte PSA Klebeschicht sorgt für eine starke Klebeverbindung.

EIGENSCHAFTEN

- Ultra weich und formanpassungsfähig
- Wärmeleitfähigkeit: 1,2 W/mK
- Wirkung bei minimalem Druck
- Extrem alterungs-/chemisch beständig
- Vibrationsdämpfend
- Leichte Vormontage durch Selbsthaftung
- Beidseitig haftend oder einseitig klebend

LIEFERFORMEN

- Matte 200 x 400 mm
- Beiseitig selbsthaftend (TGF-BXSXXXX-SI)
- Einseitige PSA Klebeschicht (TGF-BXSXXXX-SI-A1)
- Als lose Formstanzteile
- Kiss Cut Formteile auf Bogen

ANWENDUNGSBEISPIELE

Thermische Anbindung von z.B.

- SMD Bauteilen
- Through-hole Vias
- Kondensatoren
- Bauelementen an Heat-Pipes

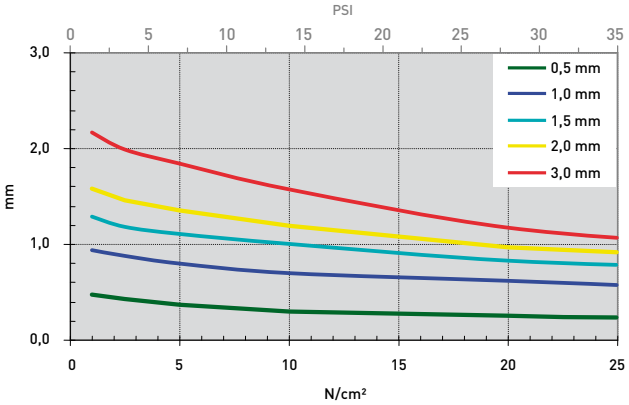
z.B. in Automotiveanwendungen / Notebooks / Medizintechnik / Industriecomputer

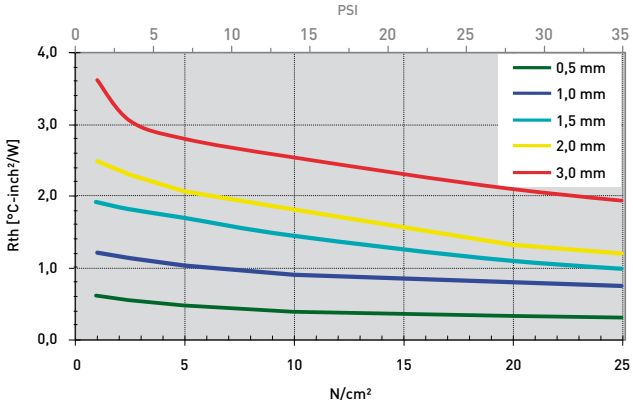
EIGENSCHAFT	EINHEIT	TGF-BXS0500-SI	TGF-BXS1000-SI	TGF-BXS1500-SI	TGF-BXS2000-SI	TGF-BXS3000-SI
MATERIAL		Silikon mit Keramikfüllung	Silikon mit Keramikfüllung	Silikon mit Keramikfüllung	Silikon mit Keramikfüllung	Silikon mit Keramikfüllung
Farbe		Rosa	Rosa	Rosa	Rosa	Rosa
Dicke	mm	0,5 ±0,10	1,0 ±0,10	1,5 ±0,15	2,0 ±0,20	3,0 ±0,30
Dichte	g/cm³	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Härte	Shore 00	30	30	30	30	30
Entflammbarkeit	UL 94	V0	V0	V0	V0	V0
RoHS Konformität	2015 / 863 / EU	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
THERMISCH						
Widerstand[1] @ 250 kPa @ Dicke	°C-inch²/W (mm)	0,31 (0,24)	0,75 (0,58)	1,00 (0,80)	1,20 (0,92)	1,95 (1,09)
Widerstand[1] @ 100 kPa @ Dicke	°C-inch²/W (mm)	0,39 (0,30)	0,90 (0,70)	1,45 (1,01)	1,81 (1,19)	2,54 (1,57)
Widerstand[1] @ 50 kPa @ Dicke	°C-inch²/W (mm)	0,48 (0,37)	1,03 (0,80)	1,70 (1,11)	2,07 (1,35)	2,80 (1,84)
Thermische Leitfähigkeit[1]	W/mK	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Betriebstemperaturbereich	°C	- 40 bis + 150	- 40 bis + 150	- 40 bis + 150	-40 bis + 150	-40 bis + 150
ELEKTRISCH						
Durchschlagsfestigkeit	kV / mm	> 6,5	> 6,5	> 6,5	> 6,5	> 6,5
Durchgangswiderstand	Ohm - cm	$3,5 \times 10^{12}$	$3,5 \times 10^{12}$	$3,5 \times 10^{12}$	$3,5 \times 10^{12}$	$3,5 \times 10^{12}$
Dielektrizitätskonstante	@ 1 MHz	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87

Prüfmethode in Anlehnung an: [1] ASTM D 5470. Typische, unverbindliche Richtwerte. Nicht für Spezifikationszwecke geeignet. Technische Änderungen vorbehalten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

Standarddicken: 0,5 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm / 2,5 mm / 3,0 mm / 3,5 mm / 4,0 mm / 4,5 mm / 5,0 / .. 12 mm

mm vs. N/cm² (PSI) / Rth vs. N/cm² (PSI)





Stand 09/2026

Technisches Datenblatt

Unsere technischen Angaben und Daten erfolgen nach bestem Wissen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik und stellen lediglich unverbindliche Informationen in Bezug auf die Produkteignung in einer Applikation sowie etwaige Schutzrechte Dritter dar. Sie befreien nicht von der Durchführung eigener Prüfungen. Verwendung und Verarbeitung der Produkte liegen außerhalb unserer Kontrolle und sind im Verantwortungsbereich des Anwenders. Änderungen der Angaben bleiben vorbehalten.